

出國報告（出國類別：國際會議）

參加 2017 ICEI 國際會議  
出國報告

服務機關：國立高雄應用科技大學

姓名職稱：廖彥助 / 電子系 博士生

派赴國家：日本-京都

出國期間：2017.5.9-2017.5.11

報告日期：2017.5.15

## 摘要

此行參加 2017 年 05 月 09 日至 05 月 11 日在日本京都研究院(Kyoto Research Park, KRP)舉辦的 2017 年第七屆工程與資訊國際會議(The 7<sup>th</sup> International Congress on Engineering and Information, 簡稱 ICEI)，由高等教育論壇(Higher Education Forum, HEF)為這次會議的主辦單位，此會議主要是從事各種工程與資訊等專業的研究員進行跨領域學科研究及實踐的國際平台。這次會議橫跨許多不同領域，包含生物、化學、電機電子及資訊等不同主題，而本次發表的主題包含了材料與熱學兩大領域，所以在這次會議有許多領域的專家也給予了許多不同的意見與經驗，讓我收穫良多。

關鍵詞：ICEI、KRP、HEF。

## 目次

一、目的 .....	1
二、過程 .....	2
三、心得及建議事項 .....	3
附錄 .....	4

## 一、目的

此行係參加2017年05月09日至05月11日在日本京都研究院(Kyoto Research Park, KRP)舉辦的2017年第七屆工程與資訊國際會議(The 7<sup>th</sup> International Congress on Engineering and Information, 簡稱 ICEI)，此會議主要是從事各種工程與資訊等專業的研究員進行跨領域學科研究及實踐的國際平台。橫跨不同領域的研究是目前科學發展很重要的一環，因此參加本次國際研討會議的目的，是期待透過多專業團隊相關研究，了解如何結合不同領域知識而發展新的研究應用，透過與會者的分享，吸取不同領域專業新知與技能及創意，運用於目前本身在半導體領域中有更多更新的創意發想與結合不同的思維，期待有新的應用出現。

## 二、過程

2017 第七屆工程與資訊國際會議(The 7<sup>th</sup> International Congress on Engineering and Information, ICED)於日本京都研究園區(Kyoto Research Park)舉辦。ICEI 為一年一度的重要國際會議，這次會議主題主要是以各種工程與資訊等領域進行跨學科領域研究。高等教育論壇(Higher Education Forum, HEF)為這次會議的主辦單位，舉辦日期為 2017 年 05 月 09 日至 05 月 11 日，會議一共三天，會議地點於日本京都市，交通十分便利與 JR 丹波口駛，即可到達京都研究園區。這次會議橫跨許多不同領域，包含生物、化學、電機電子及資訊等不同主題，而本次發表的主題包含了材料與熱學兩大領域，所以在這次會議有許多領域的專家也給予了許多不同的意見與經驗，讓我這次收穫良多。

### 三、心得及建議事項

這次所參與的 2017 ICEI 國際會議是我首次在國外以海報(poster)方式發表自己的研究結果，並與參加會議人士以英文說明發表的相關主題。此會議橫跨許多不同領域，包含生物、化學、電機電子及資訊等，與會人員來自數十個不同國家，主要來自於亞洲、美洲、歐洲，故參與此次會議的目的除了與各國研究團隊分享自己的研究成果，除了參與海報論文發表外，也積極參與其他演講場次，研討會同時有 3 個會議時同時有不同領域方面的專家學者發表，於會議中獲益良多。

所以除了獲得自己相關的研究領域知識之外，也學習到各國的學者在台上的演講表現及應答的態度。藉由這次的磨練，相信在下次的論文發表時會有很大的改變與進步，也希望下次能以口頭發表的方式呈現自己的實驗結果。在這次會議中也注意到國外的研究不單單只有專注一個部份，而是會橫跨不同領域專業的結合，而發展出新的創意，使得在研究有很大的企圖心也投注了許多心力，也激勵自己在研究方面需要更加努力。除了會議之外，在日本生活的3天也感受到日本發展的速度，如地鐵、跨境列車(巴士)便捷的交通網絡，林立的高樓大廈，發達的飯店業，及對生態的重視都市中的綠意，許多都是值得我們學習的地方。最後感謝指導教授邱建良老師的支持與鼓勵，讓我參與這次的國際研討會議更加順利。

# 附錄



